

2024年日本东京电子元器件材料及生产设备展 NEPCON JAPAN

产品名称	2024年日本东京电子元器件材料及生产设备展 NEPCON JAPAN
公司名称	广东贸发展览有限公司
价格	68000.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区盛特大厦A栋
联系电话	17819700539 17819700539

产品详情

展会介绍

日本是电子工业的强国，随着近几年来人工智能电子工业的不断发展，日本本土的电子制造业呈现出一种衰退的状态，由过去的快速销售增长到现在的依赖于电子核心部件、上游化学材料保有的优势，在这个过程中，日本市场呈现出新的需求，为中国的整机产品、配套产品制造企业介入日本市场带来了良好的契机，同时也带来了广阔的合作机遇。日本国际电子元器件、材料及生产设备展览会从1972年举办至今，在2000年，日本国际电子元器件、材料及生产设备展览会增设了IC封装技术、印制电路板以及电子元件的展览部分，进一步提高了展会的价值，使之成为“电子研发、设计以及制造等领域的国际性综合展览会”，近年，在此规模基础上又新增了关于汽车电子、电动汽车、LED/OLED照明技术以及可穿戴式电子产品等拥有良好发展前景的同期展会，这一展会随着日本电子行业的发展也在不断的成长壮大自己。近几年，来自中国、韩国、中国台湾的参展商以及观展人士不断增加。日本本就是电子行业的强国，如今它还在扩大自己。

展品范围

- 1、半导体设备和材料、集成电路、半导体分立器件、半导体照明、半导体设备；
- 2、半导体封装设备、半导体扩散设备、半导体焊接设备、半导体清洗设备、半导体测试设备、半导体制冷设备、半导体氧化设备、半导体激光设备等；
- 3、导体分立器件产品与应用技术等；
- 4、半导体光电器件；
- 5、光伏太阳能、多晶硅提纯及辅助设备、晶体硅电池及辅助设备、TFT—LCD设备；
- 6、电子元器件和组件、电子生产设备\ SMT设备（SMT生产线shebao、辅助及检测设备、OKI系列产品、防静电设备）、微组装设备（粘片、键合、清洗、检测、封焊设备）、工业辅料、粘结于密封、涂敷材

料、表面处理、润滑产品、焊接辅助材料等。

展馆信息

东京有明国际会展中心 Tokyo Big Sight International Exhibition Center

场馆面积：17000平方米

展馆地址：日本 - 东京 - 3-21-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan